

<<多芯片组>>

图书基本信息

书名：<<多芯片组>>

13位ISBN编号：9787810655811

10位ISBN编号：7810655817

出版时间：2001-08-01

出版时间：电子科技大学出版社

作者：杨邦朝 张经国

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<多芯片组>>

内容概要

多芯片组件（MCM）是一种先进的微电子组装与封装技术，是目前能最大限度发挥高集成度、高速半导体IC性能，制作高速电子系统，实现电子整机小型化和系统集成的有效途径。

本书从理论和技术两个方面全面、系统地论述了多芯片组件技术的基本概念、特点，发展MCM技术必须解决的关键技术，以及国内外多芯片技术发展现状。

全书分三篇共20章，内容包括多芯片组件的电设计和热设计技术、高密度多层布线基板技术、LSI芯

<<多芯片组>>

书籍目录

第一篇 总论

第一章 电子组装技术概述

1.1 电子组装技术的变迁

1.2 电子组装工程学

1.2.1 什么是电子组装工程学

1.2.2 电子组装工程或技术的范围与体系

<<多芯片组>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>